

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19)世界知的所有権機関
国際事務局



(43)国際公開日
2005年1月13日 (13.01.2005)

PCT

(10)国際公開番号
WO 2005/003793 A1

(51)国際特許分類7: G01R 1/073

(21)国際出願番号: PCT/JP2004/009412

(22)国際出願日: 2004年7月2日 (02.07.2004)

(25)国際出願の言語: 日本語

(26)国際公開の言語: 日本語

(30)優先権データ:
特願2003-189949 2003年7月2日 (02.07.2003) JP

(71)出願人(米国を除く全ての指定国について): 株式会社日立製作所(HITACHI, LTD.) [JP/JP]; 〒100-8280 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 Tokyo (JP).

(72)発明者; および

(75)発明者/出願人(米国についてのみ): 春日部 進 (KASUKABE, Susumu) [JP/JP]; 〒2440817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所 生産技

術研究所内 Kanagawa (JP). 山本 武志 (YAMAMOTO, Takeshi) [JP/JP]; 〒2440817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所 生産技術研究所内 Kanagawa (JP).

(74)代理人: 浅村 皓, 外 (ASAMURA, Kiyoshi et al.); 〒1000004 東京都千代田区大手町2丁目2番1号 新大手町ビル331 Tokyo (JP).

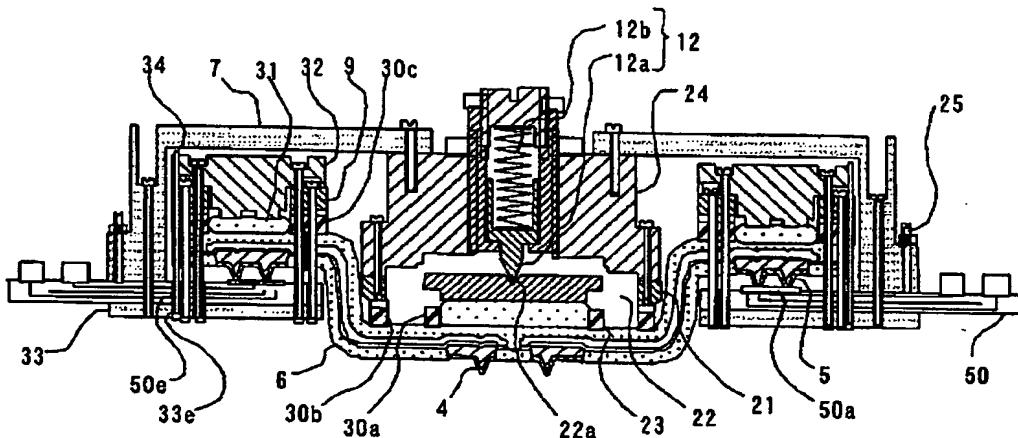
(81)指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84)指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,

(統葉有)

(54)Title: PROBE CARD AND SEMICONDUCTOR TESTING DEVICE USING PROBE SHEET OR PROBE CARD AND SEMICONDUCTOR DEVICE PRODUCING METHOD

(54)発明の名称: プローブカード及びプローブシートまたはプローブカードを用いた半導体検査装置および半導体装置の製造方法



(57)Abstract: A probe card and a probe sheet used in a testing method (production method) for a semiconductor device using the same has a first contact terminal for electric contact with the electrode of a testing subject object of narrow pitch, a wiring extending from the first contact terminal, and a second contact terminal for electric contact with the wiring, wherein the first and second contact terminals are formed by using an etched hole in a member having crystallinity and are lined with a metal sheet.

(57)要約: プローブカードおよびそれを用いた半導体装置の検査方法(製造方法)に使用されるプローブシートは、狭ピッチに形成された検査対象物の電極と電気的に接触する第1の接触端子と、該第1の接触端子から引き回された配線と、該配線と電気的に接触する第2の接触端子を有し、第1と第2の接触端子は結晶性を有する部材のエッティング穴を用いて形成し、金属シートで裏打ちされている。

WO 2005/003793 A1



SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 國際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。